

==== 型技術ワークショップ 2009 in 金沢プログラム ====

9:00 ~ 受付開始 受付 (本館 1階 大ホール前)

* 先頭が講演者

9:20	<p>講演室 A (第2研修室 本館2階) 挑戦的ものづくり技術 座長: 高谷裕治 (大阪工業, 阿部諭 (パナソニック電機))</p> <p>A-1 ATV アルミホイール高効率ラジシステムの開発 垣久信行、田岡秀樹、加藤孝一 (ホンダエンジニアリング)</p> <p>A-2 近接場光学に基づいたナノインプリント加工薄膜の精密制御計測に関する研究 池田裕一、長尾天平、高橋智、高増謙 (東京大学)</p> <p>A-3 転写型ディスプレイ (DTP) 清水崇行、井ノ口貴、増田哲也 (大同特殊鋼㈱)</p> <p>A-4 フォス型におけるペンダ加工の自動化 三上純昭 (朝アルゴグラフィックス)、富岡正、長濱治 (朝オキハラ)、加藤孝一、澤崎誠 (東芝機械マンナリー (㈱ニエート))</p>	<p>講演室 B (第3研修室 本館3階) プラスチック成形 座長: 上野孝彦 (㈱タカギセイコー)、宮丸充 (宮丸精密金型㈱)</p> <p>B-1 射出成形品板厚方向の物性値分布に与える樹脂流動の影響 瀬戸雅宏、山部昌 (金沢工業大学)</p> <p>B-2 金属光造形金型による射出成形品の構造・物性評価 長塚健伍 (金沢工業大学大学院)、杉田寿夫、阿部諭、池川直人 (パナソニック電機㈱)、瀬戸雅宏、山部昌 (金沢工業大学)</p> <p>B-3 射出成形品における成形収縮率異方性分布におよぼす保持時間の影響 梶田隆之 (三光化成)</p> <p>B-4 樹脂成形金型への Co 基合金の応用 柳原圭司、岩間明 (岩手大学)、千葉晶彦 (東北大学)、平子修嗣 (㈱ニエート)</p>	<p>講演室 C (第5研修室 本館3階) CAEと計測・評価 座長: 白井健二 (本工大)、三矢喜之 (トヨタ自動車㈱)</p> <p>C-1 CAE を活用したフレーム部品の精度向上活動 中廣一輝、田中美徳、久恒智彦 (日産自動車㈱)</p> <p>C-2 レーザによる金型レス基板非接触成形法に関する基礎研究 有限要素法による成形解析 石原将太郎、中村俊彦、青山英樹 (慶應義塾大学)</p> <p>C-3 最先端のソフトウェアバック検証と形状補正技術 瀧澤輝 (トヨタ自動車ジャパン㈱)</p> <p>C-4 5軸型マシンセンタの3次元円弧補間軌跡における NC データの影響 佐伯智之 (日本フリアテック㈱)、堤正臣 (東京農工大学)、鈴木宏祐 (㈱アリザンストン)</p>	<p>講演室 D (第6研修室 本館3階) 北陸における金型・ものづくりの取り組み 座長: 南川俊治 (石川工業試験場)、多加彦彦 (石川工業試験場)</p> <p>D-1 石川工業試験場における塑性加工解析への取り組み 新谷隆二、高野昌宏、吉田勇太、南川俊治 (石川工業試験場)</p> <p>D-2 発泡の手法 SIA を用いた省力化駆動を実現するコンピュータの軌道生成 林達夫、立矢宏、浅川直紀 (金沢大学)</p> <p>D-3 フォトメトリック方式による高精度 DLC 膜の金型への適用 瀧澤、長谷川祐史 (トヨタ技術)、安井治之、廣合滋博、南川俊治 (石川工業試験場)</p> <p>D-4 R 機を用いた迅速鋳造法について 井泉洋、井泉英紀 (船小松鋳造製作所)、藤井南、南川俊治 (石川工業試験場)</p>
	<p>10:50 ~ 11:00 実行委員長あいさつ 米山 猛 (金沢大学) 型技術協会会長あいさつ 前川 佳徳 (大阪産業大学)</p>	<p>司会: 上田 隆司 (金沢大学) 大ホール (本館1階)</p>		
12:00	<p>11:00 ~ 12:00 オープニング講演 「型技術と AC サーボレス」 コマツ 鈴木 康夫 氏 司会: 上田 隆司 (金沢大学)</p>			
13:00	<p>工作機械 座長: 上田隆司 (金沢大学)、荒井智則 (中村留密工業㈱)</p> <p>A-5 超精密5軸加工機 ナノアスファ ASPOLUX 原瀬智博、上芳啓 (㈱不二越)</p> <p>A-6 切削抵抗計測機能を持つ微小穴加工用スピンドルの開発 新井亮一、小口京吾 (東洋工業技術総合センター)、森田昇 (富山大学)、武井将伸 (㈱グライエ精密製作所)</p> <p>A-7 グラス切削が可能な超精密旋盤の開発 飯塚保、上野浩 (財)機械振興協会技術研究所、森田昇 (富山大学)</p> <p>A-8 ナメタ加工のための工具位置だし技術 小原治樹、森田昇、笹木亮 (富山大学)、大智智洋 (富山大学大学院)</p>	<p>プラスチック成形 座長: 山口輝彦 (テクノハイツ)、岡田有司 (東レエンジニアリング㈱)</p> <p>B-5 金属光造形金型を用いた熱硬化アノド成形によるウェルド低減 宮丸充 (宮丸精密金型㈱)、米山猛 (金沢大学)、阿部諭 (パナソニック電機㈱)</p> <p>B-6 繊維強化樹脂成形品のコーナ内反り現象の研究 青木健樹 (金沢工業大学大学院)、古橋洋、岡部沙也佳、荒井毅 (㈱アソテック)、瀬戸雅宏、山部昌 (金沢工業大学)</p> <p>B-7 射出成形時における金型内での固化層成長挙動に関する研究 中野拓海 (金沢工業大学大学院)、瀬戸雅宏、山部昌 (金沢工業大学)</p> <p>B-8 3次元データの有効活用と樹脂設計 織田 元一、中村正人 (㈱タカギセイコー)</p>	<p>CAEと計測・評価 座長: 戸澤幸一 (芝浦工業大学)、河本健一郎 (コマツ)</p> <p>C-5 ポルテ・スライダの変形による金型クラッシュの影響 黒瀬雅訓 (群馬工業高等専門学校)、萩口孝行、藤代功作 (㈱富津製作所)、萩原利一 (朝オキハラ)、工藤裕二 (富士重工工業㈱)、和田直明 (㈱清光金型)</p> <p>C-6 CAE と計測技術を活用した高速プレスライン対応金型の信頼性向上取り組み 佐藤英彦、佐野孝典、木内茂之 (ホンダエンジニアリング㈱)</p> <p>C-7 銅の熱伝導率における麻痺と金型寿命予測 野上芳和、森下弘一 (トヨタ自動車㈱)</p>	<p>CAD/CAM/生産システム 座長: 浅川直紀 (金沢大学)、吉本達明 (金沢大学)</p> <p>D-5 型彫り5軸加工工程設計支援システムの開発 桑野義正、寺本一成 (㈱豊田中央研究所)、神田俊之、山田良彦 (㈱ジェイテック)</p> <p>D-6 CAE 技術を利用する穴埋め作成 谷本茂樹、中村博之、荒井宏将 (日本ユニシス㈱)</p> <p>D-7 レーザによる金型レス基板非接触成形法に関する基礎研究 一実験による成形データベース構築と CAM システム構想 中川俊彦、石原将太郎、青山英樹 (慶應義塾大学)</p> <p>D-8 触覚デバイスを用いた直感的切削工程 (工具軌跡・工具姿勢) 決定システムの開発 鈴木裕美子、青山英樹 (慶應義塾大学)、佐野記章 (日本ユニシス・エクセルリョウシズン㈱)</p>
14:20	<p>休憩</p>			
14:35	<p>工作機械 座長: 森田昇 (富山大学)、中森正勝 (造谷工業㈱)</p> <p>A-9 小型超精密切削加工機の試作開発 安部規典、京谷忠幸 (㈱ビーエムティー)、上野浩 (財)機械振興協会技術研究所)</p> <p>A-10 3次元モデルシミュレーションによる機械衝突防止システムの開発 渡野剛、荒井智則 (中村留密工業㈱)</p> <p>A-11 超精密加工機 (Z/a 3500) の加工特性 塩崎圭輔、谷崎啓、高瀬亮 (コマツ NTC)</p> <p>A-12 空気静圧軸受型超精密主軸の開発に関する研究 井金秀生、高橋一彰 (インダストリー)、神雅彦 (日本工業大学)、後藤隆司、渡辺健志 (日進工具㈱)</p> <p>A-13 工作機械の加工精度維持のための設備診断、保全技術 若島浩司、土橋啓二、丹羽誠二、国見肇 (トヨタ自動車㈱)</p>	<p>切削・研削、高速ミリング、工具 座長: 野末武 (㈱不二越)、山中敏樹 (㈱ヤマカゴエーキ)</p> <p>B-9 造膜被膜を用いた金型水管内面のクリーニング 吉本達明、上田隆司、加納康弘 (金沢大学)</p> <p>B-10 車体金型への高速加工の取組み 高木慶一、三木徹 (ホンダエンジニアリング㈱)</p> <p>B-11 防錆機能を付加したエロッドミルによる高能率加工 辻潤明、関口敏、藤田朝子 (㈱不二越)</p> <p>B-12 NC データ最適化システムを用いた加工時間短縮への取組み 柳沢哲也、櫻山剛士、丸山和生 (㈱山工業㈱)</p> <p>B-13 超精密加工による超硬合金レンス金型の研削技術の開発 根本昭彦、村田泰彦 (日本工業大学)、伊藤伸英 (茨城大学)、大森賢 (理) 化学研究所)</p>	<p>放電加工・表面改質 座長: 安斎正樹 (芝浦工業大学)、澤崎誠 (㈱ソディック)</p> <p>C-8 ワイヤ放電加工における加工液流れの数値流体解析 小野田晋也、岡田英、宇野雅幸 (岡山大学大学院)</p> <p>C-9 型寿命を向上する自動車用レンス金型の型材・表面処理技術の適用事例 野坂博一、掛川智広、久恒智彦 (日産自動車㈱)</p> <p>C-10 ワイヤ放電加工の最新技術 佐藤清彦、小林浩敏、榎本謙二 (三菱電機㈱)</p> <p>C-11 高電圧パルスアノード電解加工 小原治樹、笹木亮 (富山大学)、高坂直樹 (富山大学大学院)</p> <p>C-12 金型づくりの生産効率を上げるワイヤ放電加工最新加工技術 森本日晴 (㈱ディック)</p> <p>C-13 大面積電子ビーム照射による超硬合金の表面特性向上 北田良二 (TOWA㈱)、郭洪剛 (岡山大学)、岡田晃、宇野義幸 (岡山大学大学院)</p>	<p>CAD/CAM/生産システム 座長: 青山英樹 (慶應義塾大学)、中村芳浩 (㈱キヤ)</p> <p>D-9 パラメトリックモデリングを用いた多軸加工機の経路生成手法 青木泰樹、武田昌士 (金沢大学大学院)、立矢宏、浅川直紀 (金沢大学)</p> <p>D-10 力覚 6 の自由度 Haptic Device を用いた工作機械操作インターフェイスの開発 森重トモ (電気通信大学)、山岸佑司 (電気通信大学大学院)</p> <p>D-11 2次元データモデルを用いた 3次元金型構想設計からの詳細設計の自動化について 橋口洋一 (㈱NTT データエンジニアリングシステムズ)</p> <p>D-12 イメージングを用いたテクスチャ形状の接合と形状評価 中石雅之、小林義和、白井健二 (日本大学)、前田幸久 (日本ユニシス・エクセルリョウシズン㈱)</p> <p>D-13 外形板状の高品位加工用加工機 宮地隆、下木和敏、河野淳一、藤井省 (日本ユニシス㈱)</p>
16:15	<p>休憩</p>			
16:30 ~ 17:30	<p>特別講演 「YKKのモノづくり」 YKK (株) 大村 啓 氏 司会: 戸澤 幸一 (芝浦工業大学) 大ホール (本館1階)</p>			
18:30 ~ 20:30	<p>懇親会 司会: 山部 昌 (金沢工業大学) 7階 鳳凰 (東)</p>			

#バスにて金沢都ホテルへ移動